

開示の要約

研磨装置

ウェーハに照射される光の量を調整することで正確な膜厚測定を行うことができる研磨装置が開示される。研磨装置は、光源と、研磨テーブル内の異なる位置に配置された複数の先端を有する投光ファイバーと、研磨テーブル内の異なる位置に配置された複数の先端を有する受光ファイバーとを備える。投光ファイバーは、第1投光ファイバーおよび第2投光ファイバーを有し、第1減光器は第1投光ファイバーおよび第2投光ファイバーに取り付けられ、第2減光器は第1投光ファイバーおよび第2投光ファイバーのうちの少なくとも1つに取り付けられている。

図6